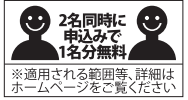


高速無線通信システムが普及がしよつとつある中、通信用半導体もまた変化を求められている。
本セミナーでは、5Gの現状を俯瞰しつ、5Gに向けた通信用半導体の技術動向について解説する。



【Live(リアルタイム)配信】 5G向け半導体技術動向

通信用半導体は高速無線通信にどう対応するのか?どう進化するのか?
米韓中の覇権戦略はどのようなものか?日本はどのように対抗すべきか?



日時	2021年2月25日(木) 10:30~16:30	会場	Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※
受講料	49,500円 ⇒テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料 定価:35,200円/S&T会員 33,440円 ※ 同一企業から複数名S&T会員で受講される場合は本割引ではなく、「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。	資料付	

講師 (有)アイパック 代表取締役 越部 茂 氏

趣旨 スマートフォンの普及により、大容量情報の移動体通信への対応=高速無線通信システム(例:5G)の構築が急務となっている。このため、無線通信用デバイスの高速化対応が注目されている。高速無線通信システムの整備には、光ファイバ網と高周波無線網の複合化および通信用電子機器の高速化が必須である。通信用電子機器は受発信部および情報処理部で構成され、高周波対策(電磁波・ノイズ)および高速伝送対策(誘電特性、伝送距離)が高速化の鍵となる。特に、電子部品の軽薄短小化による回路短縮が有効である。今回、5Gの背景および実状、そして5G電子機器の高速化対策について解説する。特に、5G電子機器の心臓部=半導体の高速化対応について詳しく説明する。

プログラム	1. 通信 1.1 回線 1.2 信号 1.3 プロトコル;階層、名称、規約類	5. 誘電対策 5.1 誘電特性と伝送損失 5.2 誘電損失低減(低誘電化、樹脂/基材)
	2. 高速通信 2.1 背景;情報社会(インターネット/スマートフォン) 2.2 光ファイバ通信 2.3 高速無線通信 2.4 高速通信システム;中長距離光通信&短距離無線通信 2.5 高速無線通信を巡る国際情勢の変化	6. 回路対策 6.1 受送信部(アンテナ、信号変換);Module可(LTCC/AiP)、IC化 6.2 情報処理部;高密度化、薄型化(RDL、薄型子基板)
	3. 高速無線通信機器 3.1 構成;受発信部、情報処理部 3.2 高速化課題;ノイズ低減、低誘電化、回路短縮	7. 半導体パッケージングの技術動向と課題 7.1 FOPK 7.2 薄層接続回路 7.3 薄層封止;封止方法、封止材料 7.4 薄層材料
	4. ノイズ対策 4.1 ノイズ;種類、伝達経路、その他 4.2 電磁波対策(空間);遮蔽(EMS)、吸収(EMA)、EMA用材料 4.3 誤信号対策(導体);フィルター、SAWフィルター用材料	8. その他 8.1 短距離光伝送;無線、光 8.2 半導体PKGの開発経緯

質疑応答

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。
セミナー資料は電子ファイルでの配布、郵送のいずれかになります。詳細はホームページをご確認下さい。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともS&T会員登録をされていた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講書、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B210265 (5G半導体)

会社名 団体名			
部署			
役職	〒		
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	S&T会員価格を適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)	
通信欄	

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様が負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

S&T サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
https://www.science-t.com

FAX 03-5733-4187

HPからもお申込みができます

検索サイトで

B210265 5G半導体

で検索!